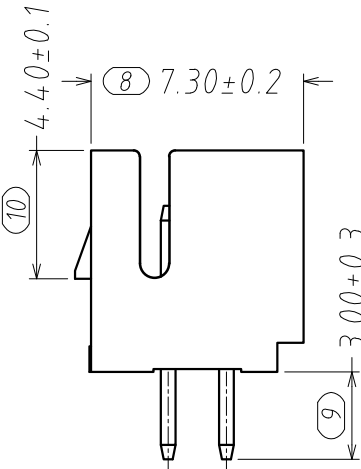
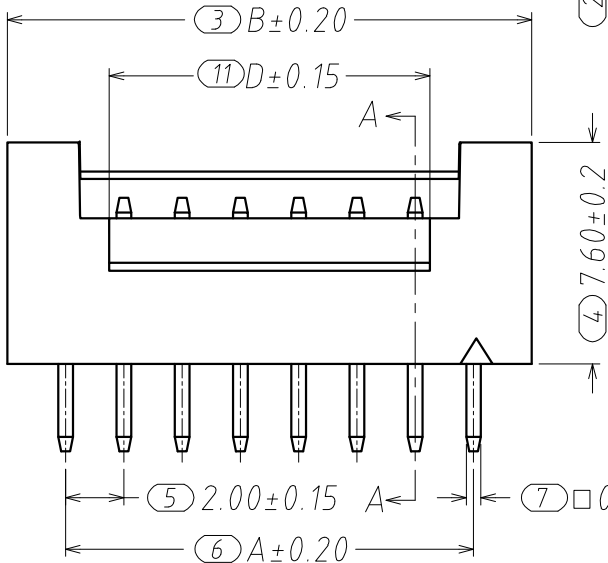
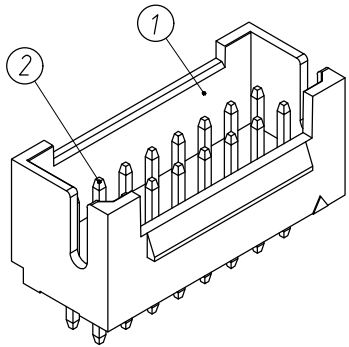
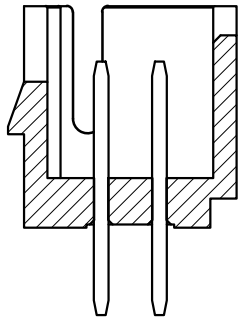
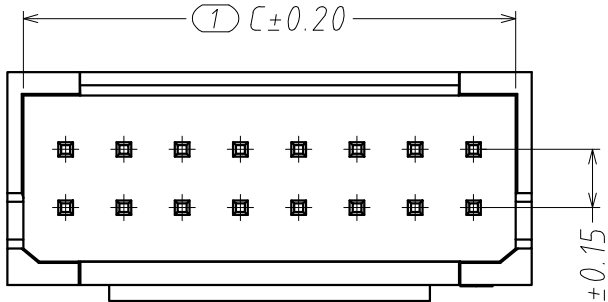


REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0		2016.11.28
B/0	升B版	2024.8.7

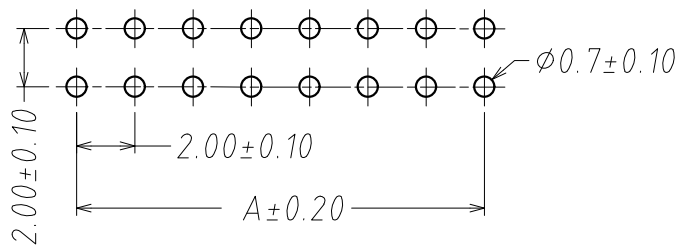


技术参数:

- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 2、额定电流: 2A, AC, DC;
- 3、额定电压: 250V, AC, DC;
- 4、温度范围: -25℃~+85℃;
- 5、接触电阻: ≤0.03Ω;
- 6、绝缘电阻: ≥1000MΩ;
- 7、耐压: 1000V, AC/minute.
- 8、适用线规: AWG#28 to #24
- 9、产品料号:

A20003 - n A - 03 T1
孔位 ———— T1: 镀亮锡
产品类型 ———— 胶芯材质
A: 直插针座 03: LCP 米色

Circuits	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
2*2	2.00	6.00	4.90	3.00
2*3	4.00	8.00	6.90	3.00
2*4	6.00	10.00	8.90	3.00
2*5	8.00	12.00	10.90	5.00
2*6	10.00	14.00	12.90	7.00
2*7	12.00	16.00	14.90	9.00
2*8	14.00	18.00	16.90	11.00
2*9	16.00	20.00	18.90	13.00
2*10	18.00	22.00	20.90	15.00
2*11	20.00	24.00	22.90	17.00
2*12	22.00	26.00	24.90	19.00
2*13	24.00	28.00	26.90	21.00
2*14	26.00	30.00	28.90	23.00
2*15	28.00	32.00	30.90	25.00
2*16	30.00	34.00	32.90	27.00



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

2	端子 Contact	黄铜	n*2	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN.
1	基座 Wafer	LCP(UL94V-0)	1	米色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 朱江浩		浙江深海电子有限公司			
0.X ±0.25		X.° ±3°		CHK. BY 丁尔特					
0.XX ±0.12				APRV. BY 姚婷					
0.XXX ±0.05		X.X° ±0.5°				SHEET		PROD. NAME SH-PHB-2*N	
UNIT		SIZE		SCALE				DRAWING NO.	
								1 OF 1	
MM		A4		1:1		H20013-00		TITLE	
								2.0mm pitch 180° WAFER-DIP TYPE	